

鼎华 DH-A3 好的专业内存卡BGA返修台拆焊台

产品名称	鼎华 DH-A3 好的专业内存卡BGA返修台拆焊台
公司名称	深圳市鼎华科技发展有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井镇万丰村大洋田工业园46栋三楼
联系电话	18902852819 18902852819

产品详情

序号	名称	用途	使用方法
1	对位头部限位杆	限制对位头部下降位置	旋转合适位置
2	显示器	显示BGA图像	插好视频接头，电源线
3	对位头部机构	吸取、安放BGA机构	
4	对位头部上下移动手柄	调节对位头部上下位置	旋转手柄
5	角度调节旋钮	精密微调BGA角度位置	旋转千分尺
6	BGA吸管	吸住BGA	
7	光学对位机构	把图像传到显示器上	用手拉出
8	上部加热风嘴	使热风更集中均匀	使出风口距BGA合适位置
9	下部加热风嘴	使热风更集中均匀	使出风口距BGA合适位置
10	横流风扇	PCB焊接后对PCB板冷却	
11	PCB板X轴调节	调节PCB板X轴移动	旋转千分尺

12	PCB板Y轴调节	调节PCB板Y轴移动	旋转千分尺
13	放大按钮	放大显示图像	按下按钮
14	缩小按钮	缩小显示图像	按下按钮
15	急停按钮	紧急停机	按下按钮
16	激光对位开关	开和关激光灯	按下按钮
17	启动开关	外部启动机器自动加热	按下
18	照明灯按钮	照明灯开关	按下按钮
19	上部加热限位杆	限制上部加热下降位置	旋转合适位置
20	上部加热机构	上部温度自动加热机构	触控里手动或自动控制
21	移动拉手	移动上部加热与对位机构	手握住
22	上部加热上下移动手柄	调节上部加热机构上下位置	旋转手柄
23	左右限位垫	定位左右移动位置	
24	激光对位	指示BGA对应的位置	按下激光对位按钮
25	工作照明灯	设备工作时照明	按下照明灯按钮
26	板夹调节	调节PCB板夹	旋松移动调节后旋紧
27	红外发热温区	拆焊BGA时预热用	
28	测温接口	连接外部电偶，测量实际温度	直接连接测温线
29	对位亮度调节	调节光学对位处亮度	左右旋转
30	触控屏	操作平台储存系统资料	

机器重量	Net weight	30kg
------	------------	------

描述：

高清触摸屏人机界面，PLC控制,并具有瞬间曲线分析功能. 实时显示设定和实测温度曲线，并可对曲线进行分析纠正。

高精度K型热电偶闭环控制和温度自动补偿系统，并结合PLC和温度模块实现对温度的精准控制，保持温度偏差在 ± 2 度.同时外置测温接口实现对温度的精密检测，并实现对实测温度曲线的精确分析和校对.

采用高精度数字视像对位系统，PCB板定位采用V字型槽，采用线性滑座，使X、Y、Z三轴皆可作精细微调或快速定位、方便、准确，满足不同PCB板排版方式及不同大小PCB板的定位.

灵活方便的可移动式万能夹具对PCB板起到保护作用，防止PCB边缘器件损伤及PCB变形，并能适应各种BGA封装尺寸的返修.；

配备多种规格合金风嘴，该风嘴可360度任意旋转定位，易于安装和更换；

上下共三个温区****加热，三个温区可同时进行多组多段温度控制，保证不同温区同步达到最佳焊接效果。加热温度、时间、斜率、冷却、真空均可在人机界面上完成设置。

上下温区均可设置6段温度控制，可以扩展成8段，可海量存储温度曲线，随时可根据不同BGA进行调用,在触摸屏上也可进行曲线分析、设定和修正；三个加热区采用****的PID算法控制加热过程，

升温更均匀，温度更准确；

采用大功率横流风机迅速对PCB板进行冷却，以防PCB板的变形，贴装、焊接、拆卸过程实现智能自动化控制；

配置声控“提前报警”功能.在拆卸、焊接完成前5-10秒以声控方式警示作业人员作相关准备。上下热风停止加热后，冷却系统启动，待温度降至常温后自动停止冷却。保证机器不会在热升温后老化！

1. 经过CE认证，设有急停开关和突发事故自动断电保护装置。

总功率	Total Power	5300W
上部加热功率	Top heater	1200W
下部加热功率	Bottom heater	第二温区1200W，第三温区2700W（加大型发热面积以适应各类
电源	power	AC220V \pm 10% 50/60Hz
外形尺寸	Dimensions	L600 \times W800 \times H850 mm
定位方式	Positioning	V字型卡槽,PCB支架可X方向调整并外配万能夹具

温度控制方式	Temperature control	K型热电偶（K Sensor）闭环控制（Closed loop）
温度控制精度	Temp accuracy	± 2度
PCB尺寸	PCB size	Max 400 × 420 mm Min 22 × 22 mm
适用芯片	BGA chip	2*2-50*50mm
适用 最小芯片间距	Minimum chip spacing	0.15mm
外置测温端口	External Temperature Sensor	1个，可扩展（optional）
机器重量	Net weight	30kg

" type="application/x-shockwave-flash">